证券代码:301099 证券简称:雅创电子 公告编号:2022-020

上海雅创电子集团股份有限公司 2021年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所由变更为安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以80,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	雅创电子	股票代码	301099
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	樊晓磊	付龙君	
办公地址	上海市闵行区春光路99弄62号4楼	上海市闵行区春光路99弄62号4楼	
传真	021-60833568	021-60833568	
电话	021-51866509	021-51866509	
电子信箱	security@yctexin.com	security@yctexin.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司主要业务及主要产品

1、主营业务概况

公司为国内知名的电子元器件授权分销商及自研IC设计商,主要从事汽车领域内的电子元器件的分销及电源管理IC的设计业务。

电子元器件分销业务:主要分销东芝、首尔半导体、村田、松下、LG等国际著名电子元器件设计制造商的产品。分销产品包括光电器件、存储芯片、被动元件和分立半导体等,主要应用在汽车照明领域及汽车座舱领域。公司通过为客户提供有竞争力的供应链服务和技术服务以实现产品销售,主要客户包括延锋伟世通、亿咖通、金来奥、法雷奥、现代摩比斯等国内外汽车电子零部件制造商。

自研IC业务:公司的产品属于模拟芯片行业中电源管理芯片范畴,应用在汽车电子领域,主要分为四大品类:马达驱动IC、LED驱动IC、LDO、DC-DC,公司已量产的相关产品均已通过AEC-Q100车规级认证,获得了广泛车企的认可,成功导入汽车品牌的供应链体系中,并向现代、起亚、克莱斯勒、大众、上汽、一汽、吉利、长城、比亚迪、小鹏等国内外知名厂商实现批量出货。

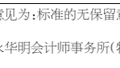
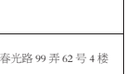
2、主要产品及其用途

1)电子元器件分销业务

公司的电子元器件分销业务为包括分销产品产生的销售收入和为客户提供委托技术服务产生的技术服务收入,基本情况如下:

(1)分销产品

电子元器件分销业务主要包括光电器件、存储芯片、被动元件、分立半导体等,相关产品情况介绍如下:

产品类型	代表产品	产品介绍	主要品牌	产品实例
光电器件	LED灯珠	LED灯珠是一种固态的半导体器件,它可直接把电能转化成可见光的固体半导体芯片,它的核心是一块可以通电发光的半导体材料,芯片被环氧树脂封装,它的两端是正负极,利用电子与空穴在半导体内部的运动,使电能转化为光能,其颜色由芯片的材料决定,常见的有红、黄、蓝、白等颜色,芯片的材料决定了LED灯珠的光学特性、热学特性、电学特性以及可靠性等。		
	汽车灯	一种通过电源驱动汽车运动的有源电流流量来实现LED灯珠的一个重要组成部分,它主要由以下部分组成:芯片、支架、焊线、封装胶等。其中芯片是LED灯珠的核心部分,它决定了LED灯珠的颜色、亮度、寿命等。焊线是将芯片与支架连接起来的导线,它的作用是将电流从支架传入芯片。封装胶是用来保护芯片和焊线不受外界环境影响的一种材料,它可以防止水分、灰尘、污染物等对芯片和焊线的侵蚀,同时还可以起到增强光学效果、提高亮度和延长寿命的作用。		
	汽车插入器	一种用于为汽车提供电力连接的电子元件,它通常由外壳、端子、触点、弹簧、电线等组成。外壳是插入器的主体部分,它通过螺丝或卡扣固定在汽车内部的某个位置上。端子是插入器的核心部分,它通过与电线连接来实现电力传输。触点是端子上的一个小部件,它通过与对方端子接触来实现电力传输。弹簧是用来保证触点之间的压力,以确保电力传输的稳定性。电线是将电力从汽车内部引出到外部设备上的导线,它通过与插入器连接来实现电力传输。		
存储芯片	NAND闪存芯片	一种用于大容量数据存储的闪存芯片,它采用了NAND结构来组织数据,这种结构使得芯片能够以更高的密度和更低的成本来存储数据。NAND闪存芯片通常用于各种电子设备中,如智能手机、平板电脑、数码相机、固态硬盘等。它具有高速读写、低功耗、长寿命等特点,是现代数据存储领域中不可或缺的一部分。		
	DRAM芯片	一种半导体存储器,通常与CPU直接连接,以提高数据传输的速度和效率。它采用电容来存储数据,每个电容可以存储一个比特的信息。DRAM芯片通常用于计算机、服务器、游戏机、智能手机等设备中,作为主要的内存。它的优点是容量大、速度快、成本较低,但需要定期刷新以保持数据的稳定性。		
分立半导体	IGBT等	这类产品主要用于高压、大电流、高频率、高效率的电力电子设备中,如变频器、逆变器、电焊机、电动汽车、太阳能逆变器、风力发电设备、工业电机控制、家用电器、照明系统、电动工具、医疗设备、通信设备、汽车电子、智能电网、轨道交通、航空航天、军工等。IGBT具有高开关频率、低导通压降、高耐压、高电流、高可靠性、长寿命、易于驱动、节能环保、小型化、轻量化、模块化、智能化、高集成度、高稳定性、高安全性、高兼容性、高性价比、高定制化、高技术含量、高附加值、高市场需求、高竞争力、高利润、高增长、高前景、高投资、高回报、高风险、高挑战、高机遇、高发展、高创新、高合作、高共赢、高共享、高共担、高责任、高使命、高愿景、高理想、高追求、高目标、高成就、高荣誉、高尊重、高信任、高支持、高鼓励、高奖励、高惩罚、高压力、高动力、高活力、高魅力、高吸引力、高凝聚力、高向心力、高离心力、高排斥力、高吸附力、高解决力、高应对力、高适应力、高调整力、高改变力、高革新力、高创新力、高突破力、高超越力、高卓越力、高完美力、高极致力、高顶峰力、高巅峰力、高登峰力、高攀峰力、高征服力、高战胜力、高克服力、高克制力、高克己力、高克人力、高克物力、高克自力、高克他力、高克天力、高克地